

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

二零二二年全年業績新聞稿

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止全年業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二三年三月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。



**ASMPT 公布二零二二年全年業績：
二零二二年第四季度銷售收入高於預期
連續七個季度毛利率超過 40%**

集團業績概覽

集團財務概要：二零二二年第四季度

- * 銷售收入為港幣 43.3 億元(5.53 億美元)，按年-30.2%，按季亦-5.1%
- * 新增訂單總額為港幣 31.2 億元(3.98 億美元)，按年-40.6%，按季亦-14.0%
- * 毛利率為 41.4%，按年+8 點子，按季亦+55 點子
- * 經營利潤率為 13.7%，按年-633 點子，按季亦-74 點子
- * 盈利為港幣 2.67 億元，按年-70.7%，按季亦-56.8%
- * 每股基本盈利為港幣 0.65 元，按年-70.7%，按季亦-56.7%

集團財務概要：二零二二年

- * 銷售收入為港幣 193.6 億元(24.7 億美元)，按年-11.8%
- * 新增訂單總額為港幣 184.4 億元(23.6 億美元)，按年-29.4%
- * 毛利率為 41.1%，按年+55 點子
- * 經營利潤率為 16.7%，按年-216 點子
- * 盈利為港幣 26.2 億元，按年-17.5%
- * 每股基本盈利為港幣 6.36 元，按年-17.6%
- * 於二零二二年十二月三十一日，未完成訂單總額為港幣 89.8 億元(11.5 億美元)
- * 二零二二年全年合計每股派息為港幣 3.20 元，按年-17.9%

二零二三年第一季度銷售收入預測

- * 將介乎 4.55 億美元至 5.25 億美元之間

詳盡業績公布及投資者簡報可見於

<https://www.asmpt.com/zh-tw/investors/financials-results/>

(二零二三年三月一日，香港訊) — **ASMPT Limited** (「ASMPT」 / 「集團」 / 「本公司」) (股份代號: 0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬件和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績。

集團繼於二零二一年「超級週期」錄得銷售收入創新高的表現後，再創下年度銷售收入及新增訂單總額¹第二新高紀錄。此外，儘管二零二二年的宏觀經濟環境充滿挑戰，集團的第四季度銷售收入仍高於預期，並連續七個季度錄得逾40%的毛利率。

¹ 不包括物料業務的貢獻，該業務自二零二零年十二月二十九日已不再納入合併，並以權益法入賬。

集團二零二二年亮點

- 全年銷售收入為港幣 193.6 億元(24.7 億美元)，按年下跌 11.8%，但仍創下集團年度銷售收入第二新高紀錄。
- 全年新增訂單總額為港幣 184.4 億元(23.6 億美元)，由於二零二一年的基數較高，按年下跌 29.4%，但仍創下集團年度新增訂單總額第二新高紀錄。
 - 先進封裝（「AP」）、汽車及工業合共佔集團的新增訂單總額約 60%。
 - 未完成訂單總額為港幣 89.8 億元(11.5 億美元)，訂單對付運比率為 0.95。
- 由於有利的產品組合、針對性的定價調整和持續策略性措施，在 SEMI 和 SMT 兩個分部的共同推動下，集團的毛利率為 41.1%，按年提升 55 點子。由於全球供應鏈緊張，使物料和物流成本上升，抵消了部份增長。
- 由於集團銷售收入下降以及通脹導致經營成本增加，集團的經營利潤率為 16.7%，按年下降 216 點子。
- 隨著銷售收入及經營利潤率下降，集團的盈利按年下跌 17.5%至港幣 26.2 億元。
- AAMI合營公司(物料業務的合營公司)於二零二二年的業績創新高。
- 儘管在二零二二年為二零二一年超級週期年度支付豐厚股息和股票回購後，集團於二零二二年十二月三十一日仍錄得強勁的現金和銀行存款為港幣 44.2 億元。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「儘管宏觀經濟存在不確定性，但集團於二零二二年仍表現強韌。我們獨特兼廣泛的產品組合繼續是我們主要的競爭優勢，使我們能夠減輕行業週期對集團的影響。在我們的 SEMI 和 SMT 分部，我們的產品組合為我們提供主流及應用工具的批量業務，以及能力去推動我們的高增長及高利潤先進設備（包括軟件解決方案）的發展。我們相信，集團在逐步整合及優化整體解決方案套件方面具有無可比擬的能力，並將繼續支持我們在市場中蓬勃發展和競爭。」

SMT – 表現出色

於二零二二年，集團的 SMT 分部表現強勁，年度分部銷售收入創新高，其佔集團新增訂單總額的百分比亦創新高。此增長乃受惠於分部在汽車和工業終端市場應用的強勁市場地位，有關市場佔 SMT 總銷售收入近半，其中尤其是來自歐洲和美洲市場，對其高端配置及印刷設備的需求強勁。

汽車業務 – 銷售收入創新高

集團全面的汽車解決方案能滿足目前及未來的市場需要，使其越來越受歡迎。集團的激光切割、燒結及SMT配置解決方案的需求上升，並引入更多頂級客戶。集團的解決方案已愈來愈多為純電動車（「EV」）客戶提供服務，包括快速增長的中國電動車客戶。在汽車電動化迅速發展的趨勢下，集團的汽車終端市場應用為二零二二年的銷售收入貢獻約5.15億美元的新高水平，按年增長20%。汽車終端市場應用佔集團總銷售收入比例亦創新高，達21%。

先進封裝 – 表現震撼

集團或已擁有業內涵蓋SEMI及SMT分部最全面先進封裝解決方案。於二零二二年，AP需求強勁，為集團整體銷售收入貢獻約5億美元，佔約20%。若干亮點如下：

- **熱壓焊接（「TCB」）**：作為公認的市場領導者，集團超過1億美元的TCB未完成訂單，預期將於二零二三年完成大部份，並已再次取得關於高頻寬記憶體（「HBM」）的TCB訂單，預測未來的需求仍將穩健向前。集團在領先的邏輯垂直整合製造商及晶圓代工客戶的鼎力支持下，正投入開發新一代的環保、超微間距的晶片與晶圓TCB設備，並預期此等先進的TCB設備將於二零二三年第一季度末開始交付給客戶認證。集團的TCB解決方案現已可實現低於1微米的高配置精確度。
- **面板級電化學沉積（「ECD」）設備**：集團主導全球市場份額，在高性能計算（「HPC」）需求帶動下，其在全球多個大批量生產（「HVM」）地點均有使用。值得提及的是，集團位於馬來西亞的業務已開始付運這些組件，使有關業務更接近集團在亞洲的客戶。
- **系統封裝（「SiP」）SMT印刷及配置**：隨著5G、智能手機及高端可穿戴裝置普及，此領域的需求強勁，且此長期趨勢預期繼續推動客戶的長期資本投資計劃。展望未來，新的晶片裝嵌解決方案將於二零二三年推出市場，以回應客戶對高速及高精度固晶配置解決方案的需求。
- **激光切割**繼續提高市場份額，皆因對更複雜先進晶片架構的需求加速增長。集團已提高其產能，由新加坡的業務付運設備，以更接近其更多主要客戶，並且相信下一代激光切割設備可為集團貢獻至少1億美元的長期年銷售收入。

- **先進顯示屏和矽光子（「SiPh」）設備**:在市場對無縫且大呎寸的顯示屏需求不斷增長的支持下，集團的小型LED解決方案有助加快先進顯示屏於大眾市場的滲透。集團領先的先進顯示屏解決方案已準備就緒以滿足微型LED的HVM需求。SiPh方面，集團的AMICRA設備為市場領導者，獲主要一級企業採用作光纖通訊。

集團二零二二年第四季度亮點

集團的表現優於市場預測，銷售收入為港幣 43.3 億元 (5.53 億美元)，按季僅下跌 5.1%，超過上一季度業績公告發布的 4.55 億美元至 5.25 億美元的銷售收入預測上限。

集團的新增訂單總額為港幣 31.2 億元 (3.98 億美元)，主要由於二零二一年的基數較高按年下跌 40.6%，由於一般季節性影響按季亦下跌 14.0%。

集團連續七個季度錄得逾 40% 的毛利率。毛利率為 41.4%，分別按年增長 8 點子及按季增長 55 點子。盈利為港幣 2.67 億元，當中包括約港幣 2 億元的外幣匯兌淨損失，按年下跌 70.7%及按季下跌 56.8%。

股息

集團董事會建議派發派末期股息每股港幣 1.90 元。連同中期股息每股港幣 1.30 元，於二零二二年度全年合計每股派息為港幣 3.20 元。集團致力維持每年約 50%派息比率的股息政策。

展望二零二三年和二零二三年第一季度銷售收入預測

從集團客戶的反饋和行業觀察家的見解看來，市場普遍認為半導體行業有機會在二零二三年下半年開始復蘇。

縱觀集團的業務，有些令人鼓舞的利好因素。集團踏入二零二三年時有大量未完成訂單，預計大部分的未完成訂單將於二零二三年交付。集團亦繼續看好汽車、工業和先進封裝市場的優勢，主要由其長期趨勢以及眾多企業不斷努力建立強韌的供應鏈所支持。最後，集團獨特兼廣泛的產品組合為其奠定堅實的基礎和關鍵競爭優勢。

就短期前景而言，隨着半導體仍處於下行週期和宏觀經濟的不確定性影響，集團預計二零二三年第一季度的銷售收入將介乎在 4.55 億美元至 5.25 億美元之間，以其中間數計按年下跌 27.4%及按季下跌 11.4%。

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT (香港聯交所股份代號: 0522) 是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT 總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及 SMT (表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及 LED(顯示板)。ASMPT 與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT 是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數及恒生香港 35 指數之成份股。詳細資訊請查閱 ASMPT 網頁 <https://www.asmpt.com/>。

前瞻聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻聲明。這些前瞻聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，不同因素可能導致實際結果與前瞻聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻聲明，而 ASMPT 不會承擔任何公開地更新或修訂任何前瞻聲明的義務。本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢:

林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
電話: +65 6450 1445
電郵: eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT:

縱橫財經公關顧問有限公司
吳燕霞 / 梁頌欣 / 卓愷瑩
電話: 2864 4812 / 2864 4862 / 2114 4979
傳真: 2527 1196
電郵: mandy.go@sprg.com.hk / vivienne.leung@sprg.com.hk / christina.cheuk@sprg.com.hk